



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国半导体材料行业市场 分析及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2008年中国半导体材料行业市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/43839.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

半导体材料是整个电子信息产业基础的基础，对整个电子信息产业的发展起着重要的支撑作用。2006年全球半导体材料的市场规模比上年增长16.9%。从不同领域看，份额最大是占全体37%的“半导体晶圆”市场，其次是占23%的“封装相关”市场，然后是占12%的“光刻相关”市场，富士经济预计2012年的材料市场总体将比2006年增加28.0%，达到4.11万亿日元。按半导体材料市场面向前工序或后工序来看，2006年的前工序材料市场，占半导体材料市场总体的6成以上，达到2.75万亿日元，后工序材料市场达到1.1346万亿日元。

虽然日本目前还是全球最大的IC制造国，但从发展来看，随着轻晶圆策略的实施和IDM与Foundry更多的合作，中国大陆、台湾和东南亚已成为全球半导体产业的主要增长地区。半导体市场的发展自然带动了相关材料市场的增长。经历了连续3年创纪录的增长后，未来两年的发展依然看好。2007年Fab材料的增长将为9%，达到240亿美元，封装材料市场将增长13%，达到166亿美元。市场的增长对材料供应商来说是好消息，但面对原油等原材料价格的上涨和IC价格下降的双重压力，材料供应商只能是喜忧参半。未来3大引人注目市场是：高介电质材料、NF3以及各向异性导电薄膜。

目前，我国半导体支撑材料业的发展很不平衡，与国际高科技产品相比较还存在一些差距。因此，国内半导体材料企业应该“苦练内功、夯实基础”，不断提高工艺水平，加强技术创新力度，让产品上档次，满足高端市场的需求。这样才不会忧虑国外厂商大举进入带来的激烈竞争，更不用担心国外先进技术带来的巨大冲击，反而可以吸引更多的大型厂商进入国内市场，形成一种良好的竞争机制与环境，促进半导体材料市场的健康发展以及国内电子信息产业企业的技术进步与产业升级。与半导体产业链上其他环节相比，国家对半导体材料产业的支持相对较弱，业界在不断呼吁，相关政策应尽快延伸到材料业。

【 目录 】

第一部分 行业发展概述

第一章 半导体材料概述 1

第一节 半导体材料定义 1

第二节 半导体材料分类	2
第三节 化合物半导体材料介绍	3
第四节 半导体材料特性和参数	5
第五节 半导体材料制备	6
第六节 半导体材料技术动向及挑战	7

第二部分 国内外发展现状

第二章 世界半导体材料市场分析	15
第一节 世界总体市场概况	15
一、国际半导体材料市场发展概览	15
二、全球半导体材料的进展	17
三、全球半导体材料市场现状调查	20
四、第二代半导体材料砷化镓发展概况	21
五、第三代半导体材料GaN发展概况	22
第二节 北美半导体材料发展分析	23
一、北美半导体设备与材料市场	23
二、美国半导体材料市场发展现状及预测	25
三、普林斯顿大学用原子移栽手段获得磁性半导体材料	26
四、美国利用氧化锌和钴混合物开发新半导体材料	26
五、美国Intermolecular发表半导体组合技术	27
六、美科学家科技发现新型碳晶体管胜过非晶硅	28
七、道康宁在半导体材料方面的研究进展	31
八、SAFCHitech公布硅半导体基片技术	32
九、霍尼韦尔研究解决半导体热管理难题	34
十、杜邦在台湾成立半导体材料技术中心	35
十一、IBM和JSR合作研发新型材料推进半导体制造技术	35
第三节 亚洲半导体材料发展	36
一、日本半导体材料巨头增加投资以提高产能	36
二、日本开发出有机半导体新材料	36
三、瑞萨科技发布硅锗功率晶体管	37
四、韩国积极扶持半导体及原材料产业	40
五、台湾半导体设备材料市场	41

第四节 欧洲半导体材料市场发展情况 43

- 一、英国推出应用于半导体领域的PEEK材料 43
- 二、德国科学家利用硅材料研制发光器件 44
- 三、适合于CMOS的有机半导体材料开发情况 44

第五节 世界半导体材料发展趋势 45

- 一、半导体材料市场加速转移之势 45
- 二、32nm以下IC半导体性能提升靠材料技术的新突破 46

第三章 中国半导体材料行业分析 53

第一节 行业发展概况 53

- 一、国内半导体材料发展情况 53
- 二、我国IC支撑材料瓶颈待突破 56
- 三、政策支持力度有待加强 58
- 四、中国半导体设备与材料市场概览 59
- 五、发展我国半导体材料的建议 61

第二节 技术开发及应用 63

- 一、我国半导体材料研究进展 63
- 二、湖南高精度数控多线切割机床打破国外技术垄断 71
- 三、半导体材料竞争无线应用领域 72
- 四、SOI技术瓶颈突破 76
- 五、有机半导体材料的设计、合成和场效应晶体管研究获新进展 79

第三节 半导体封装材料行业分析 79

第四节 中国半导体材料进出口状况 88

- 一、2007年进出口总量统计 88
- 二、2007年半导体材料进口统计 90
- 三、2007年半导体材料出口统计 91

第三部分 主要半导体材料分析

第四章 主要半导体材料发展分析 93

第一节 硅晶体 93

- 一、国际多晶硅产业概况 93
- 二、国内多晶硅产业概况 96

三、我国多晶硅产业发展的喜与忧	98
四、两岸太阳能企业积极布局多晶硅原料	102
五、未来多晶硅行业发展的趋势分析	103
六、太阳能多晶硅现货价失控	104
第二节 砷化镓	105
一、2010年前砷化镓设备的防务市场将持续走强	105
二、日AKE砷化镓晶圆厂瞄准霍耳组件市场	105
三、ANADIGICS昆山投建6英寸砷化镓晶圆制造厂	106
四、中显3T-VGF法砷化镓单晶棒试产成功	106
五、中科晶电砷化镓材料开始规模化生产	107
六、4英寸砷化镓化合物半导体芯片生产线落户南京	108
七、砷化镓产业发展情况	108
第三节 GaN	114
一、半导体材料GaN产业现状	114
二、GaN产业市场投资前景	115
三、中科院研制成功氮化镓基激光器	116
第四节 碳化硅	117
一、SiC概况	117
二、碳化硅市场分析	119
三、碳化硅在LED产业发展中的应用	122
四、中国SiC项目公司简介	125
五、日本精工技研公司确立碳化硅晶圆研磨量产技术	129
六、NipponSteel碳化硅晶圆生产技术取得突破	130
七、天富热电第三代半导体材料碳化硅项目投产	131
八、中科院物理所合作建立国内首条碳化硅晶片中试生产线	132
九、南京鑫启硅业新建碳化硅生产线正式投产	132
十、国内碳化硅晶体发展情况	133
十一、碳化硅将领航新型功率半导体器件材料	134
第五节 其他半导体材料	136
一、非晶半导体材料介绍	136
二、锆金属需求旺盛价格坚挺	137
三、用磷化铟等材料制成的半导体光子集成芯片	139

四、可印式氧化物半导体材料技术发展 141

第四部分 半导体业发展现状

第五章 半导体行业发展分析 149

第一节 国内外半导体产业发展情况 149

一、国内外半导体产业简况 149

二、2007年半导体厂商竞争力分析 153

三、我国半导体业持续快速增长 157

四、2007年半导体市场评述 160

五、光伏半导体设备市场旺销 169

六、中国内地半导体产业的“生态”环境 172

第二节 中国半导体市场发展形势及预测 181

一、国内外半导体市场形势分析 181

二、2007全球半导体市场发展及2008年预测 191

三、2008年全球半导体产业发展分析预测 195

四、Gartner修改2008年半导体行业设备投资预测 199

五、深圳市打造全球最大化合物半导体基地 200

第六章 主要半导体市场分析 203

第一节 LED产业发展 203

一、全球LED产业发展 203

二、全球LED专利布局 211

三、LED技术发展 219

四、LED应用市场 225

五、中国LED产业发展与前景 238

第二节 电子元器件市场 251

一、全球电子元器件行业需求回暖 251

二、中国电子元件产量占全球四成 256

三、电子元件业升级三大利器 257

四、2007年电子元器件业主要经济指标 260

五、我国电子元器件产业发展前景广阔 263

第三节 集成电路 267

一、2007上半年中国集成电路产业市场研究	267
二、中国集成电路业面临四大瓶颈	268
三、国内外集成电路技术发展现状及差距	269
四、集成电路技术发展趋势	273
五、2007年半导体集成电路产品产量	275
第四节 半导体分立器件	280
一、中国半导体分立器件市场发展概况	280
二、半导体分立器件发展新思维	283
三、中国大陆半导体分立器件主要靠进口	286
四、半导体分立器件未来的发展趋势	287
五、2007年半导体分立器件产量	289
第五节 其他半导体市场	296
一、半导体气体与化学品产业发展趋势	296
二、IC光罩市场概况分析	297
三、2007年掩膜市场发展情况	299

第五部分 主要厂商分析

第七章 半导体材料主要生产商 301

第一节 有研半导体材料股份有限公司 301

- 一、企业概况 301
- 二、发展情况 303
- 三、财务分析 304

第二节 天津中环半导体股份有限公司 307

- 一、公司概况 307
- 二、控股子公司概况 308
- 三、业务发展情况 309
- 四、财务分析 310

第三节 峨嵋半导体材料厂 312

- 一、企业概况 312
- 二、发展成就 313

第四节 四川新光硅业科技有限责任公司 318

- 一、公司概况 318

二、公司发展	320
第五节 洛阳中硅高科技有限公司	320
一、企业概况	320
二、技术研发	322
第六节 宁波立立电子股份有限公司	323
一、公司概况	323
二、产品介绍	324
三、发展战略	324
第七节 宁波康强电子股份有限公司	325
一、公司概况	325
二、公司发展情况	326
三、公司经营情况	329
第八节 南京国盛电子有限公司	332
一、公司简介	332
二、工艺技术与产品	333
第九节 中科镓英半导体有限公司	333

第六部分 行业投资分析

第八章 半导体材料投资分析	337
一、国内企业投资多晶硅形势分析	337
二、半导体新材料表征所面临的挑战	339
三、低K材料在半导体集成电路中的应用与展望低K材料	344
四、半导体玻璃应用前景广阔	346
五、新材料帮助封装解决冷却问题	348
六、其他领域厂商纷纷涉足LSI新材料领域	350
七、化合物半导体前景	350

图表目录

图表：元素半导体的性质与结构	3
图表：- 化合物半导体的性质	4
图表：- 化合物半导体的性质	4
图表：部分二元化合物半导体的性质	5

图表：CZT薄膜的能隙 E_g 与组分的关系	5
图表：1998年IBM公司使用自有的CMOS7S制程技术来产制的芯片	8
图表：High-k材料与SiO ₂ 材料比较	10
图表：德国西门子公司用单晶硅材料制成的太阳能基板	11
图表：红光LED的照射使植物（农作物）增长图	13
图表：日本2004年上半年度(4~9月)化合物半导体材料出厂情况	17
图表：半导体用材料的定义及范围	18
图表：2006年-2009年全球电子级硅片总消耗量预测	19
图表：2006-2008年管芯制造材料预测	19
图表：2005年全球半导体材料市场规模	19
图表：2005-2009年全球半导体材料市场规模及预测	24
图表：瑞萨科技RQG2003产品的功能总结	38
图表：2000-2007年全球Fab产能分布的变化	45
图表：2007年半导体材料市场分布统计与预测	46
图表：High-k/metalgate材料技术的演进发展	47
图表：Dualmetal与Dualhigh-k的比较	48
图表：藉由电极矩改变Gate的功函数	50
图表：在金属闸极中添加不纯物	50
图表：2003-2009年中国大陆芯片生产电子材料市场规模及预测	61
图表：2001-2005年中国半导体封装材料市场规模及增长	80
图表：2005年中国半导体封装材料市场结构	80
图表：2005年国内半导体引线框架制造企业产能分布及市场份额	83
图表：2005年国内金丝生产企业市场份额	84
图表：2007年1-10月经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等进出口总量统计	88
图表：2007年1-10月经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等进口分省份统计	90
图表：2007年1-10月经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等出口分省份统计	91
图表：2002-2010年全球及中国太阳能级多晶硅需求量统计及预测	94
图表：2005-2010年全球太阳能电池产量统计与预测	95
图表：2005年世界主要多晶硅生产企业产能及生产情况	96
图表：2003-2006年国内多晶硅生产产量趋势图	97
图表：砷化镓与硅的组件特性比较	109
图表：砷化镓微波三种元件结构之特性的比较	110

图表：砷化镓产业上下游关联图	112
图表：砷化镓微波组件的商业运用	113
图表：不同碳化硅类型情况简介	118
图表：碳化硅晶片生产及应用前景情况	118
图表：碳化硅晶片生产企业情况	119
图表：碳化硅晶片生产工艺	120
图表：LED产业链	122
图表：可见光LED分类及应用	123
图表：不同衬底材料下的外延情况	124
图表：不同衬底下外延的比较	124
图表：中国碳化硅项目公司股权结构	125
图表：北京天科合达蓝光半导体公司碳化硅项目优势	126
图表：北京天科合达蓝光半导体公司碳化硅晶片项目成本费用情况(以4万片产量计算)	127
图表：2006-2011年北京天科合达蓝光半导体公司碳化硅晶片的产能和销售预测	128
图表：2006-2011年北京天科合达蓝光半导体公司两英寸碳化硅晶片的生产成本和销售价格及国际市场价格预测	128
图表：2006年锗消费领域需求比例示意图	139
图表：非晶型氧化镓镓锌材料系统组成比例(右)与电子迁移率(左)	142
图表：五种基本的印制方式	143
图表：典型传统印制技术应用之基材种类与印制材料及其最小线宽	144
图表：软式微影技术的组件制作流程	145
图表：高分辨率软式微影技术压印头印制250nm×250nm方柱图	146
图表：由100 μm玻璃背板及30 μm聚合物双层模块成具有270nm图案之压印头实例	146
图表：传统印制技术与软式微影技术相对应的比较	147
图表：全球半导体应用领域分布	149
图表：2005年全球半导体分类产品销售收入	150
图表：2006年排名前十位的半导体公司	150
图表：2003-2005年半导体市场向亚太地区转移	151
图表：2007年全球20大半导体供应商的排名	154
图表：2007年按公司总部所在地对全球半导体销售额的初步估计	155
图表：2006-2007年9月全球半导体销售收入和同比增长率	161
图表：2006年12月-2007年9月电子元器件行业销售额数据	162

图表：2006年9月-2007年9月半导体集成电路产量数据	162
图表：2005年9月-2007年9月电子元件行业销售收入和利润总额变动情况	163
图表：2005年9月-2007年9月电子器件行业销售收入和利润总额变动情况	163
图表：2007-2010年电子级硅晶圆出货量预测	164
图表：2006年10月-2007年9月PCB行业订单出货比数据	165
图表：2005年10月-2006年9月PCB行业订单和出货同比增长数据	166
图表：2006年10月-2007年9月刚性PCB订单出货比数据	166
图表：2006年10月-2007年9月柔性PCB订单出货比数据	167
图表：2007年1-9月TFT-LCD面板销售额及增长状况	168
图表：2007年6-10月显示器和笔记本电脑用面板价格走势	168
图表：2007年6-10月液晶电视用面板价格走势	169
图表：2007年6-10月中小尺寸TFT-LCD面板价格走势	169
图表：我国集成电路生产线统计	175
图表：2006年我国内地IC封装测试企业收入前十名	176
图表：Isuppli对2007年全球半导体市场的四次预估	181
图表：Gartner对2007年全球半导体市场预测的变化轨迹	182
图表：2006年一季度-2007年二季度中国集成电路产业增长趋势	183
图表：1999-2011年中国集成电路市场增长率趋势及预测	184
图表：Isuppli对2005年全球半导体市场的预期变动情况	185
图表：Isuppli对2007年一季度半导体超额库存的预估与实际情况	185
图表：2005年3月-2007年9月北美半导体设备BB值	186
图表：2004年一季度-2007年三季度台积电各季度收入、毛利变动情况	188
图表：台积电2007年前三季度与全年预期增长率	188
图表：2008年四大代工厂合计资本支出及资本密集度预期	189
图表：2008Q1半导体销售收入预估	190
图表：Isuppli对2007-2011年全球半导体市场预估	190
图表：2006-2009年世界主要地区半导体产业发展预测	194
图表：2006-2007年国际主要PC厂商出货量	194
图表：2005-2011年全球半导体行业设备投资额及预测	199
图表：全球主要LED业者概况	204
图表：2000-2011年全球LED市场成长及预测	204
图表：2003-2006年全球蓝光晶粒产能分布	205

图表：全球高亮芯片主要应用领域分布（按销售额统计）	205
图表：全球高亮芯片主要应用领域分布（按销售量统计）	205
图表：全球主要LED领先厂商	210
图表：2003-2006年全球主要LED大厂迎运收入	211
图表：LED产业链投资规模估算	211
图表：国际半导体照明专利状况对比	211
图表：全球七大LED巨头专利数分布	212
图表：LED发光效率演进	221
图表：各种照明技术发光效率与光电转换效率变化	221
图表：LED基本分类与应用市场	225
图表：传统亮度与高亮度LED产品应用市场	225
图表：2006-2010年全球手机出货量预测	227
图表：各种手机用面板技术比较	227
图表：2006-2010LED背光模组出货趋势	232
图表：2003-2009年全球照明市场规模及预测	234
图表：2004-2006年蓝光LED芯片价格变化	236
图表：2002-2007年一季度白光LED分季度价格走势	236
图表：LED应用市场发展路线图	238
图表：国内主要LED产业基地及其核心企业	239
图表：2006年国内各种材料体系芯片市场销售额分布	241
图表：2006年度国内LED芯片需求量及国产率状况	241
图表：2003-2010年国内GaN芯片产能发展预测	242
图表：国内LED产品的应用领域分布	244
图表：我国半导体照明产业中下游优劣势比较	247
图表：2007年1-8月电子器件制造主要经济指标	260
图表：2007年1-8月电子元件制造主要经济指标	262
图表：2006年一季度-2007年二季度中国集成电路产业销售规模及增长	267
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量全国合计	275
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量北京市合计	276
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量天津市合计	276
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量辽宁省合计	276
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量上海市合计	277

图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量江苏省合计	277
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量浙江省合计	277
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量安徽省合计	278
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量福建省合计	278
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量山东省合计	278
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量广东省合计	279
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量四川省合计	279
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量贵州省合计	280
图表：2007年2-10月半导体集成电路产品产量甘肃省合计	280
图表：2003-2007年中国大陆半导体分立器件国产产销走势及预测	287
图表：2003-2007年中国大陆半导体分立器件需求与进口走势及预测	287
图表：2006年中国大陆进口半导体分立器件主要货源	287
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量全国合计	289
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量北京市合计	289
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量天津市合计	289
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量河北省合计	290
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量辽宁省合计	290
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量吉林省合计	291
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量黑龙江省合计	291
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量上海市合计	291
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量江苏省合计	292
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量浙江省合计	292
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量安徽省合计	292
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量福建省合计	293
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量江西省合计	293
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量山东省合计	293
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量河南省合计	294
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量湖北省合计	294
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量湖南省合计	294
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量广东省合计	295
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量广西区合计	295
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量四川省合计	295

图表：2007年2-10月半导体分立器件产量贵州省合计	296
图表：2007年2-10月半导体分立器件产量陕西省合计	296
图表：半导体气体与化学品技术发展蓝图	297
图表：2005年光罩企业全球市占率	298
图表：有研硅股200mm硅抛光片规格	301
图表：有研硅股150mm硅抛光片规格	302
图表：2007年上半年有研半导体材料股份有限公司主营构成	304
图表：2007年前三季度有研半导体材料股份有限公司利润分配表	304
图表：2007年前三季度有研半导体材料股份有限公司获利能力表	305
图表：2007年前三季度有研半导体材料股份有限公司经营能力表	305
图表：2007年前三季度有研半导体材料股份有限公司偿债能力表	306
图表：2007年前三季度有研半导体材料股份有限公司资本结构表	306
图表：2007年前三季度有研半导体材料股份有限公司发展能力表	306
图表：2007年前三季度有研半导体材料股份有限公司现金流量分析表	306
图表：2007年上半年天津中环半导体股份有限公司主营构成	310
图表：2007年前三季度天津中环半导体股份有限公司利润分配表	310
图表：2007年前三季度天津中环半导体股份有限公司获利能力表	311
图表：2007年前三季度天津中环半导体股份有限公司经营能力表	311
图表：2007年前三季度天津中环半导体股份有限公司偿债能力表	311
图表：2007年前三季度天津中环半导体股份有限公司资本结构表	312
图表：2007年前三季度天津中环半导体股份有限公司发展能力表	312
图表：2007年前三季度天津中环半导体股份有限公司现金流量分析表	312
图表：新光硅业公司股东及持股比例	319
图表：立立电子抛光片产品规格	324
图表：立立电子外延片产品规格	324
图表：康强电子IPO前后股权结构	325
图表：2003-2007年全球引线框架市场规模及增长率	329
图表：2003-2007年中国引线框架市场规模及增长率	329
图表：2004-2007年公司产品主营业务利润同比增长率	330
图表：2003-2009年康强电子主营业务增长及预测	330
图表：2003-2009年康强电子毛利率及预测	331
图表：2007年康强电子引线框架产能分布	331

图表：2009年康强电子引线框架产能分布预估 331

图表：中科镓英磷化铟整片产品规格 334

图表：2005-2006年我国多晶硅企业筹建、新建、扩建情况 337

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43839.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景；

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴；

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等；

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。